PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-053075

(43)Date of publication of application: 25.02.1994

(51)Int.Cl.

H01G 4/12

H01G 4/30 H01G 4/42

(21)Application number: 04-219719

(71)Applicant: MITSUBISHI MATERIALS CORP

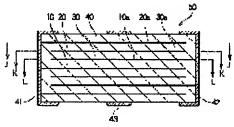
(22)Date of filing: 27.07.1992

(72)Inventor: DAANARU PII BAAKUSU

(54) LAMINATED CERAMIC CAPACITOR FOR BALANCED LINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To miniaturize the title capacitor to make it possible to lessen the mounting area of the capacitor, to mount the capacitors on a circuit board in a high density to make it possible to miniaturize an electronic equipment, to improve the responsibility of the capacitor to a filter and to remove a high-frequency noise. CONSTITUTION: Dielectric sheets 10, on the respective surfaces of which each internal electrode 10a, which is extended to one outer periphery of a laminated material and is apart at an interval from the outer periphery on the opposite side to this outer periphery, is formed, dielectric sheets 20, on the respective surfaces of which each internal electrode 20a, which is extended to the outer periphery on the opposite side and is apart at an interval from the one outer periphery, is formed, and dielectric sheets 30, on the respective surfaces of which each internal electrode 30a, which is extended to the mutually opposed two outer peripheries, to which both electrodes 10a and 20a are not extended, and is apart at



intervals from the mutually opposed two outer peripheries to which both electrodes 10a and 20a are extended, is formed, are alternately stacked to form the laminated material. Moreover, one pair of external electrodes 41 and 42, which are connected to both of the electrodes 10a and 20a, are formed on both side surfaces of the laminated material and external electrodes 43, which are connected to the electrodes 30a, are formed on another both side surfaces of the laminated material. Thereby, three pieces of capacitors are built in the title capacitor and three terminals are integrally formed.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-53075

(43)公開日 平成6年(1994)2月25日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 1 G	4/12	3 4 6			
	4/30	301 A	8019-5E		
		D	8019-5E		
	4/42	3 3 1	9174-5E		

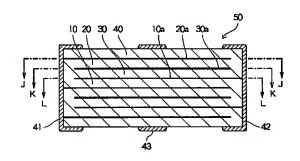
		審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁
(21)出願番号	特顧平4-219719	(71)出願人 000006264 三菱マテリアル株式会社
(22)出願日	平成 4 年(1992) 7 月27日	東京都千代田区大手町1丁目5番1号 (72)発明者 ダーナル ピー パークス 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 菱マテリアル株式会社セラミックス研究所 内
		(74)代理人 弁理士 須田 正義

(54)【発明の名称】 平衡線路用積層セラミックコンデンサ

(57)【要約】

【目的】 小型で実装面積が少なくて済み、髙密度に回 路基板に実装して電子機器を小型化でき、かつフィルタ 応答性を改善して、髙周波ノイズを除去する。

【構成】 1つの外周辺まで延びこの外周辺と反対側の 外周辺とは間隔をあけて内部電極10aを表面に形成し た誘電体シート10と、前記反対側の外周辺まで延び前 記1つの外周辺とは間隔をあけて内部電極20aを表面 に形成した誘電体シート20と、両電極10a, 20a の延びていない相対向する2つの外周辺まで延び両電極 10a, 20aの延びている相対向する2つの外周辺と は間隔をあけて内部電極30aを表面に形成した誘電体 シート30とを交互に積重ねて積層体45を形成する。 積層体の両側面に両電極10a,20aに接続する一対 の外部電極41、42を形成し、積層体の別の両側面に 電極30aに接続する外部電極43を形成する。3個の コンデンサが内蔵され3端子が一体化される。



- 10 第1セラミック誘電体シート(第1セラミックグリーンシート)
- 10a 第1内部電極
- 20 第2セラミック誘電体シート(第2セラミックグリーンシート)
- 20年 第2内部電極
- 30 第3セラミック誘電体シート(第3セラミックグリーンシート)
- 30a 第3内部電極
- 41 第1外部電極 42 第2外部電極
- 43 第3外部電極
- 50 積層セラミックコンデンサ

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 1つの外周辺まで延びこの外周辺と反対 側の外周辺とは間隔をあけて第1内部電極(10a)が表面 に形成された角形の第1セラミック誘電体シート(10)

前記反対側の外周辺まで延び前記1つの外周辺とは間隔 をあけて第2内部電極(20a)が表面に形成された角形の 第2セラミック誘電体シート(20)と、

前記第1及び第2内部電極(10a,20a)の延びていない相 極(10a,20a)の延びている相対向する2つの外周辺とは 間隔をあけて第3内部電極(30a)が表面に形成された第 3セラミック誘電体シート(30)とを交互に積重ねて形成 された積層体(45)と、

前記積層体(45)の両側面にそれぞれ形成され前記第1及 び第2内部電極(10a,20a)に接続する平衡線路接続用の 一対の第1及び第2外部電極(41,42)と、

前記積層体(45)の別の両側面にそれぞれ形成され前記第 3内部電極(30a)に接続する接地用の第3外部電極(43) とを備えた平衡線路用積層セラミックコンデンサ。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電話機、モデム等の通信 回路、或いはDC-DCコンバータ等の電源供給回路の 平衡線路にチップ型ノイズフィルタ(chip noise filte r)として用いられる積層セラミックコンデンサに関す る。更に詳しくは3個のコンデンサが内蔵されかつ3端 子が一体化された、電磁妨害ノイズ(electromagnetic inter-ference)を吸収するに適したチップ型のバイバ スコンデンサに関するものである。

[0002]

【従来の技術】との種の通信回路又は電源供給回路に は、一対の入力線路とアース線路からなる三線の平衡線 路 (three wire balanced line) が使用される。こうし た回路には同相ノイズ (common-mode noise) や差動ノ イズ (differential noise) を除去するためにローパス フィルタ又はバイパスフィルタが必要である。具体的に は、図17に示すように入力線路Aとアース線路Gとの 間に積層セラミックコンデンサC1を、入力線路Bとア ース線路Gとの間に積層セラミックコンデンサC、を、 また入力線路AとBの間に積層セラミックコンデンサC ,をそれぞれ接続したフィルタがしばしば用いられる。 従来、上記3個の積層セラミックコンデンサのそれぞれ は、1つのシート外周辺まで延びこのシート外周辺と反 対側のシート外周辺とは間隔をあけてシート表面に内部 電極が形成された角形の2枚のセラミック誘電体シート を一組とし、これら2枚のセラミック誘電体シートを内 部電極の延びたシート外周辺がそれぞれ反対側になるよ うに重ね合せ、この重ね合せた一組のセラミック誘電体 の両側面にそれぞれ露出した内部電極に接続して形成さ れた一対の外部電極とを備える。そして3個のコンデン サはプリント回路基板に別々に実装される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 このため、従来の3個 の積層セラミックコンデンサからなるフィルタでは、個 別にコンデンサを基板に実装するため、ブリント配線が 複雑になり、プリント配線の残留インダクタンスのた め、フィルタとしてのノイズ吸収性能に劣っていた。更 対向する2つの外周辺まで延び前記第1及び第2内部電 10 にコンデンサを基板に実装する際に、基板に広い実装面 積を必要とし、電子機器を小型化できない問題点があっ た。本発明の目的は、小型で実装面積が少なくて済み、 髙密度に回路基板に実装して電子機器を小型化できる平 衡線路用積層セラミックコンデンサを提供することにあ る。本発明の別の目的は、単一の素子で3個のコンデン サを近接して内蔵しかつ3端子を一体化することによ り、フィルタ応答性が改善された、三線の平衡線路にお ける同相ノイズや差動ノイズの除去が可能な平衡線路用 積層セラミックコンデンサを提供することにある。

20 [0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本発明の構成を図1、図5及び図8に基づいて説明す る。本発明の積層セラミックコンデンサ50は、1つの 外周辺まで延びこの外周辺と反対側の外周辺とは間隔を あけて第1内部電極10aが表面に形成された角形の第 1セラミック誘電体シート10と、前記反対側の外周辺 まで延び前記1つの外周辺とは間隔をあけて第2内部電 極20 a が表面に形成された角形の第2セラミック誘電 体シート20と、両電極10a, 20aの延びていない 30 相対向する2つの外周辺まで延び両電極10a,20a の延びている相対向する2つの外周辺とは間隔をあけて 第3内部電極30 aが表面に形成された第3セラミック 誘電体シート30とを交互に積重ねて積層体45が形成 される。更に、この積層体45の両側面には両電極10 a, 20 a に接続する平衡線路接続用の一対の第1及び 第2外部電極41,42がそれぞれ形成され、この積層 体45の別の両側面には第3内部電極30aに接続する 接地用の第3外部電極43がそれぞれ形成される。

[0005]

【作用】図8に示すように、コンデンサ50を線路A, 40 B. Gに接続すると、第1外部電極41と第2外部電極 42との間で差動ノイズを吸収するための1つのコンデ ンサC,が形成され、第1外部電極41と第3外部電極 43との間及び第2外部電極42と第3外部電極43と の間でそれぞれ同相ノイズを吸収するための2つのコン デンサC₁及びC₂が形成される。このような構成のチッ プ型の積層セラミックコンデンサは、3個のコンデンサ が内蔵されかつ3つの端子電極41,42,43が積層 体45の側面に一体化するので、第一にフィルタ応答性 シートを複数組積層し一体化してなる積層体と、積層体 50 が改善され、第二に3個のコンデンサを単一の素子の形 態で、僅かなスペースと僅かな工数で回路基板に実装す るととができる。

[0006]

【実施例】次に、本発明の実施例を図面に基づいて詳し

<実施例1>先ず、誘電体グリーンシートを多数枚用意 した。この誘電体グリーンシートはポリエステルベース シートの上面にチタン酸バリウム系のJIS-R特性を 有する誘電体スラリーをドクターブレード法によりコー ティングした後、乾燥して形成される。これらのグリー 10 て、3つのコンデンサのキャパシタンスは次式で表わさ ンシートのうち、ある1群を第1セラミックグリーンシ ートとし、別の群を第2セラミックグリーンシートと し、更に別の群を第3セラミックグリーンシートとし た。次いで第1、第2及び第3セラミックグリーンシー トの各表面にそれぞれ別々のパターンでAg/Pdを主 成分とする導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃ で4分間乾燥した。即ち、図5に示すように第1セラミ ックグリーンシート10の表面には、1つの外周辺まで 延びこの外周辺と反対側の外周辺とは間隔をあけて第1 内部電極10aが印刷形成された。また第2セラミック 20 順に積層した。この最上層には導電性ペーストを全く印 グリーンシート20の表面には、前記反対側の外周辺ま で延び前記1つの外周辺とは間隔をあけて第2内部電極 20aが印刷形成された。更に第3セラミックグリーン シート30の表面には、両内部電極10a,20aの延 びていない相対向する2つの外周辺まで延び両内部電極 10a, 20aの延びている相対向する2つの外周辺と は間隔をあけて十字状の第3内部電極30aが印刷形成 された。この例では、3つの内部電極10aと20aと 30aの各面積はそれぞれ等しい。

【0007】図1及び図5に示すように、この例では第 30 2誘電体シート20の上に、第1誘電体シート10、第 3誘電体シート30、第2誘電体シート20、第1誘電 体シート10、第3誘電体シート30、及び第2誘電体 シート20をこの順に積層した。この最上層には導電性 ベーストを全く印刷していない第4セラミックグリーン シート40を重ね合わせて合計8層の積層体45を得 た。この積層体45を熱圧着して一体化した後、130 0℃で約1時間焼成して焼結体を得た。この焼結体をバ レル研磨して焼結体の周囲側面に内部電極10a,20 a. 20 a が露出する焼結体の両端部にそれぞれAgを 主成分とする導電性ペーストを塗布し、また内部電極3 0 a が露出する焼結体の中央部の全周に同じ導電性ベー ストを塗布した後、これらの導電性ペーストを焼付けて 一対の第1及び第2外部電極41,42と第3外部電極 43をそれぞれ形成した。とれにより、図7に示す積層 セラミックコンデンサ50が得られた。

【0008】この積層セラミックコンデンサ50の特性 を調べるために、図8に示すように一対の入力線路A及 びBとアース線路Gのある三線の平衡線路にこの積層セ 50 記例に限られるものではなく、必要とされるキャパシタ

ラミックコンデンサ50を接続した。具体的には積層セ ラミックコンデンサ50の第1外部電極41を線路A に、第2外部電極42を線路Bに、第3外部電極43を 線路Gにそれぞれ接続した。この平衡線路に髙周波ノイ ズ、電磁波等を混入した信号を流したところ、第1外部 電極41と第2外部電極42との間で差動ノイズが吸収 され、第1外部電極41と第3外部電極43との間及び 第2外部電極42と第3外部電極43との間でそれぞれ 同相ノイズが吸収された。この例では図8の回路におい れる。

$$C_1 = C_2 = C_3 \tag{1}$$

【0009】<実施例2>図9~図12は本発明の実施 例2の積層セラミックコンデンサの断面図である。これ **らの図において、図1~図4に示した符号と同一符号は** 同じ構成部品を示す。この例では第1誘電体シート10 の上に、第3誘電体シート30、第2誘電体シート2 0、第3誘電体シート30、第1誘電体シート10、第 3誘電体シート30、及び第2誘電体シート20をこの 刷していない第4セラミックグリーンシート40を重ね 合わせて合計8層の積層体45を得た。この例では、内 部電極30aの面積は内部電極20aと30aの各面積 の半分である。その他の構成は実施例1と同じであるの で、繰返しの説明を省略する。との積層セラミックコン デンサの特性は、実施例1と同様であった。ただし、こ の例では図8の回路において、3つのコンデンサのキャ バシタンスは次式で表わされる。

$$C_1 = C_2 = C_3/2.5$$
 (2)

【0010】<実施例3>図13~図16は本発明の実 施例3の積層セラミックコンデンサの断面図である。 と れらの図において、図1~図4に示した符号と同一符号 は同じ構成部品を示す。この例では第2誘電体シート2 0の上に、第1誘電体シート10、第2誘電体シート2 0、第3誘電体シート30、第1誘電体シート10、第 2誘電体シート20、第1誘電体シート10、第3誘電 体シート30、及び第2誘電体シート20をこの順に積 層した。この最上層には導電性ペーストを全く印刷して いない第4セラミックグリーンシート40を重ね合わせ a及び30aを露出させた(図6)。この内部電極10 40 て合計10層の積層体45を得た。この例では、3つの 内部電極10aと20aと30aの各面積はそれぞれ等 しい。その他の構成は実施例1と同じであるので、繰返 しの説明を省略する。との積層セラミックコンデンサの 特性は、実施例1と同様であった。ただし、この例では 図8の回路において、3つのコンデンサのキャパシタン スは次式で表わされる。

$$C_1 = C_2 = C_3/2$$
 (3)

【0011】なお、本発明のセラミック誘電体シートの 積層数、接地用の第3内部電極30aの面積の広さは上 5

ンスに応じて適宜変更することができる。

[0012]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、単一の素子で3個のコンデンサを内蔵しかつ3端子を一体化した小型のコンデンサを実現したので、ブリント回路基板への実装面積を広く必要とせず、僅かな工数で実装でき、同時にフィルタ応答性を改善できる。また、三線の平衡線路における同相ノイズや差動ノイズの除去することができ、電磁妨害維音(EMI)を吸収するチップ型ノイズフィルタ(CNF)として好適に利用できる。更に、第1内部電極の面積に対して第2内部電極の面積を可変にすれば、内蔵するコンデンサのキャパシタンスを変更できる利点もある。

【図面の簡単な説明】

【図2】そのJ-J線断面図。

【図3】そのK-K線断面図。

【図4】そのL-L線断面図。

【図5】その積層体の積層前の斜視図。

【図6】その積層体を焼成した焼結体の斜視図。

【図7】その焼結体に第1~第3外部電極を設けて作製された積層セラミックコンデンサの斜視図。

【図8】その積層セラミックコンデンサを平衡線路に接続した回路図。

【図9】本発明別の実施例の積層セラミックコンデンサの $C_1 = C_2 = C_1/2$. 5の関係が成立する図1に対応 *

*する断面図。

【図10】そのM-M線断面図。

【図11】そのN-N線断面図。

【図12】その〇一〇線断面図。

【図13】本発明別の実施例の積層セラミックコンデンサの $C_1 = C_2 = C_3 / 2$ の関係が成立する図1に対応する断面図。

【図14】そのP-P線断面図。

【図15】そのQ-Q線断面図。

10 【図16】そのR-R線断面図。

【図17】従来の積層セラミックコンデンサを平衡線路 に接続した回路図。

【符号の説明】

10 第1セラミック誘電体シート (第1セラミックグリーンシート)

10a 第1内部電極

20 第2セラミック誘電体シート (第2セラミックグリーンシート)

20a 第2内部電極

20 30 第3セラミック誘電体シート (第3セラミックグリーンシート)

30a 第3内部電極

41 第1外部電極

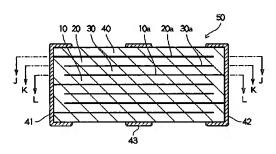
42 第2外部電極

43 第3外部電極

45 積層体

50 積層セラミックコンデンサ

【図1】

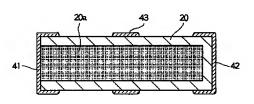


- 10 第1 セラミック誘案体シート (第1 セラミックグリーンシート)
- 10a 第1内部電極
- 20 第2セラミック誘電体シート(第2セラミックグリーンシート)

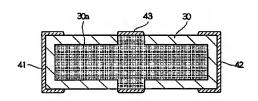
20a 第2内部電極 30 第3セラミック露電体シート 第3セラミックグリーンシート)

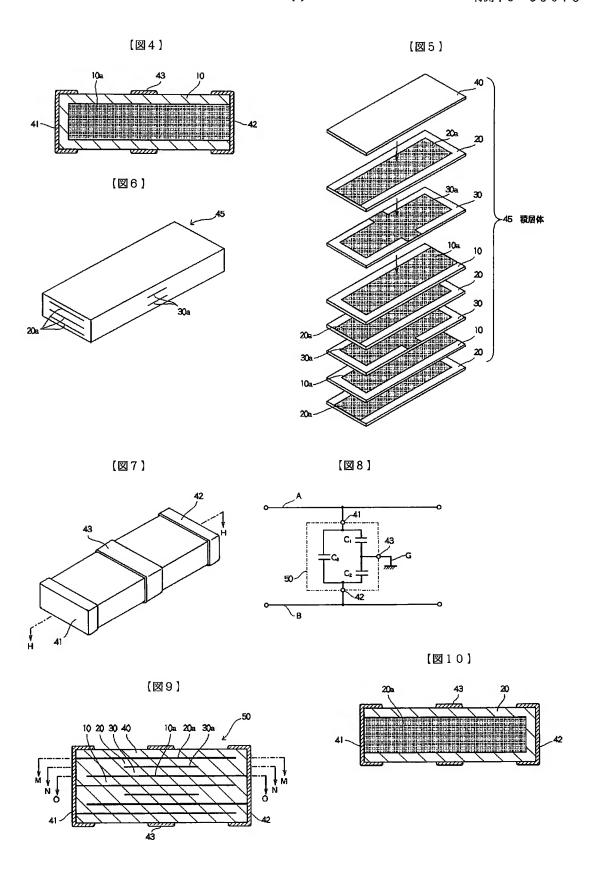
- 30a 第3内部電極
- 41 第1外部電極
- 42 第2外部電極
- 43 第3外部電極 50 積層セラミックコンデンサ

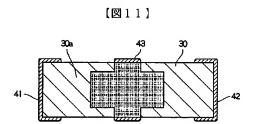
[図2]



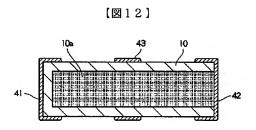
【図3】



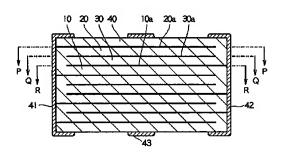




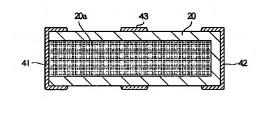
【図13】



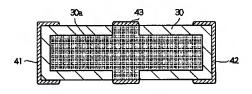
【図14】



【図15】



【図16】



【図17】

